

ペレット定盤(PT30) R401(20%) TEST (SF9B-2M 両面機)

結晶ガラス基板 Φ65mm 0.607~0.609mm 30枚 (面圧 101g/cm²)

研磨試験1

加工方法

(1) WA砥石 #240 ドレス 1分

(2) 加工条件 荷重 開始時40kg 100kgまで30秒で増加 100koで 1分間加工 下定盤回転数 40rpm

	時間(分)	厚み(mm)		研磨量(um)	加工RATE(um/min)	Ra	Rz	備考
加工前	0	0.607	+0.002					
①	1	0.592		15	15.0	0.459	3.894	
②	2	0.572		20	20.0	0.494	4.328	
③	3	0.555		17	17.0			
④	4	0.536		19	19.0	0.478	3.610	
⑤	5	0.517		19	19.0	0.459	3.675	キャリア研磨 0.537→0.505→0.465(2min)
⑥	6	0.498		19	19.0			

研磨試験2

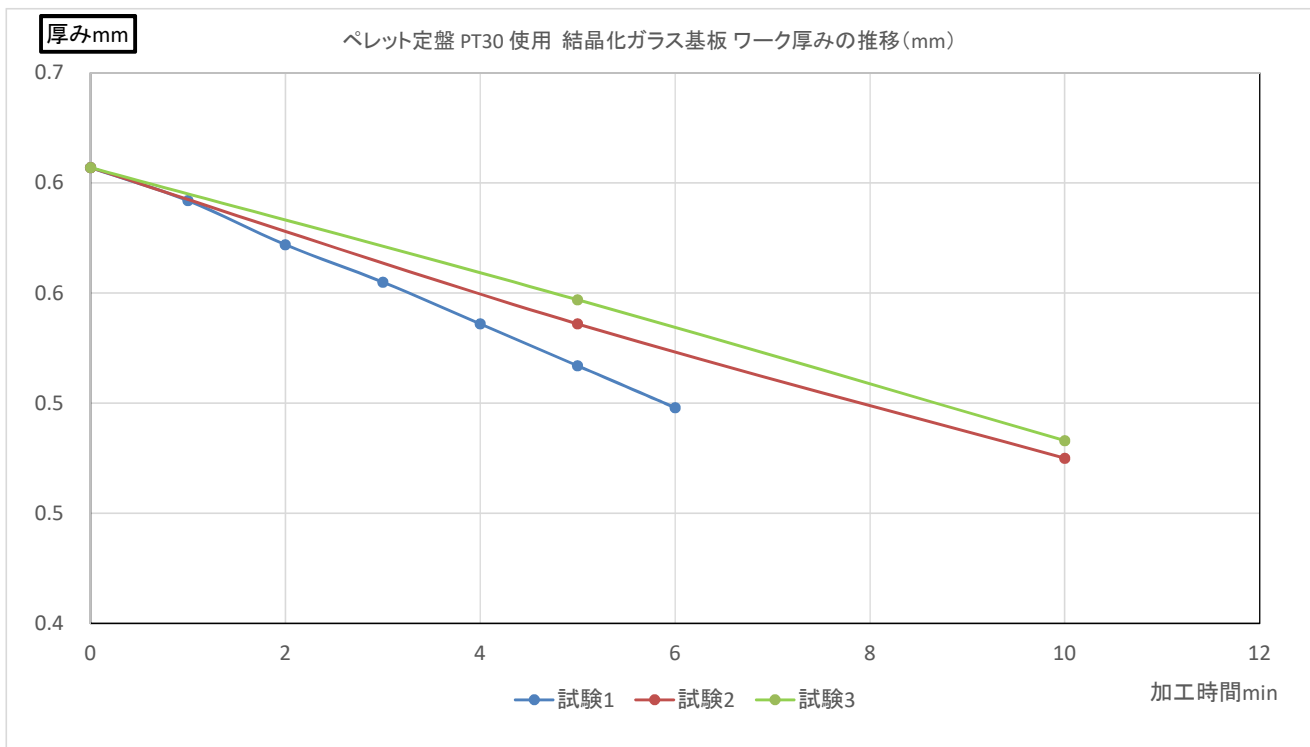
(3) 加工条件 荷重 開始時40kg 100kgまで30秒で増加 100koで 5分間加工 下定盤回転数 40rpm

	時間(分)	厚み(mm)		研磨量(um)	加工RATE(um/min)	Ra	Rz	備考
加工前	0	0.607	+0.002					
①	1	0.536		71	14.2	0.459	3.894	
②	2	0.475		61	12.2	0.494	4.328	

研磨試験3

(4) 加工条件 荷重 開始時40kg 100kgまで30秒で増加 100koで 5分間加工 下定盤回転数 40rpm

	時間(分)	厚み(mm)		研磨量(um)	加工RATE(um/min)	Ra	Rz	備考
加工前	0	0.607	+0.002					
①	1	0.547		60	12.0			
②	2	0.483		64	12.8			



ペレット定盤(PT30) R401(20%) TEST (SF9B-2M 両面機)

結晶ガラス基板(コーティング品) Φ65mm 0.636~0.640mm 30枚 (面圧 101g/cm²)

研磨試験4

(5) 加工条件 荷重 開始時40kg 100kgまで30秒で増加 100koで 5分間加工 下定盤回転数 40rpm

	時間(分)	厚み(mm)		研磨量(um)	加工RATE(um/min)	Ra	Rz	備考
加工前	0	0.636	+0.004					
①	1	0.599		37	7.4			

ペレット定盤(PT100) R401(20%) TEST (SF9B-1M 両面機)

結晶ガラス基板 Φ65mm 0.636~0.640mm 30枚(コーティング品) (面圧 101g/cm²)

研磨試験5

加工方法

(1) WA砥石 #240 ドレス 1分

(2) 加工条件 荷重 開始時40kg 100kgまで30秒で増加 100koで 1分間加工 下定盤回転数 40rpm

	時間(分)	厚み(mm)		研磨量(um)	加工RATE(um/min)	Ra	Rz	備考
加工前	0	0.636	+0.004					
①	1	0.575		61	61.0	0.882	6.415	
②	2	0.508		67	67.0			